

# 不断地为绿色、低成本、高可靠制造“添砖加瓦”

斯倍利亚贸易（上海）有限公司总经理 藤本贵史



**我**们始终把针对高密度实装化、零部件微细化的微细焊接接合部的可靠性作为重要课题之一，特别是针对肉眼无法识别的气孔，开发使气孔减少、提升可靠性的无铅焊锡膏。

秉承低成本、高可靠性的宗旨，我们将继续研制针对焊接难题的铝材焊接材料、高温无铅焊锡、Sn-Zn系焊锡膏。

特别在产品的供货方面，我们无论经受怎样的局面，都会以一如既往保持品质不变，按照签约价格稳定供货为使命。

在NEPCON China 2012上，我们将展出拥有实绩13年的无铅SN100C与SN100C advantage系列第1款含银SN99CN产品，以及减少环境负荷的无卤素焊接材料。

SN99CN[焊锡膏 SN99CN P520 D4；焊锡球 SN99CN(Sn-1.1Ag-0.7Cu-0.05Ni+ $\alpha$ )]在高速冲击条件下拉伸实验结果(Cu-OSP基板)呈现出SN99CN > SN100C  $\geq$  Sn-37Pb > Sn-3.0Ag-0.5C的吸收能量大小顺序，是针对微细焊接合部实现高接合强度的产品。

同时，我们还将在展会上重点介绍以下产品：

活性持续性提高的无铅焊锡丝SN100C(551CT)。助焊剂活性力持续性优越，烙铁脱锡良好且抑制锡尖发生，是最适合手动拉锡焊接及锡桥修补等的高可靠性焊锡丝。

第2代完全无卤素焊接材料无铅焊锡膏SN100C P602 D4。

确保高活性，完全无卤素型(不含F、Cl、Br、I)无铅焊锡膏。引脚端湿润爬升良好，抑制气孔的发生。显示出SN100C(Sn-0.7Cu-0.05Ni+Ge)的优越合金特性，能与锡银铜系无铅焊锡在同等的温度范围下使用。

第2代完全无卤素焊接材料，焊接用助焊剂NS-F900。湿润性(氧化铜)优越的无卤素焊接用助焊剂，不含卤素(F、Cl、Br、I)，是完全无卤素型高可靠性筒装助焊剂。引脚部湿润爬升及焊锡流动性良好，最适合贴片零件及搭载离散元件的印刷线路板的无铅焊接。

(上接第8页)

多高混合小批量产品的订单，同时确保了最低生产成本。

因此，在市场低迷时期，我们的客户依然业绩良好；当经济繁荣时，他们甚至做得更好，原因在于当市场需求增加时，他们无需投入巨资重新配置其现有生

产线，为什么？这是因为他们使用的是Europlacer适应性企业平台(Europlacer Adaptable Business Platform)，该平台通过供料器、软件及其他配件的正向和反向兼容性，确保全面保护客户的投资；该平台可帮助降低新系统的

配置成本，进而最终降低每次贴装的成本。

因此，我们的客户在电子制造市场始终保持竞争优势，这是因为他们在最短的生产周期内可交付优质产品，同时对需要其电子制造服务的客户收取实惠合理的费用。